

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临2026-026

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于 2026 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日上午11:00-12:00通过价值在线路演中心（网址：<https://www.ir-online.cn/>）以网络文字互动的方式召开了2026年半年度业绩说明会，针对公司2026年半年度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2026年8月28日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2026-025），并向广大投资者征集大家所关心的问题。

公司于2026年9月7日上午11:00-12:00，通过价值在线路演中心（网址：<https://www.ir-online.cn/>）以网络文字互动的方式召开了2026年半年度业绩说明会。公司董事长兼总经理王蔚先生、董事会秘书兼财务总监段佳国先生、独立董事刘海燕女士出席了本次说明会，针对公司2026年半年度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题一：1、报披露汇兑净损失约2254万元、管理费用因Anteryon分拆中介费增加约1500万元，请问这两项是否均属一次性/可逆扰动？2026年下半年汇兑

端能否通过对冲平衡回正，分拆中介费是否H2出清，从而使Q3单季归母净利同比降幅收窄到个位数？2、苏州新增两条12寸车规CIS/WLCSP产线H1中后段才量产，请问目前整体稼动率大概区间？公司内部对Q3单季稼动率目标是多少，新线预计何时达到盈亏平衡，能否让Q3单季营收环比Q2（3.42亿）明显提升至3.8亿以上？3、Anteryon阿姆斯特丹分拆上市目前处于监管审批/招股书准备哪一阶段？预计2026年内能否完成挂牌，H1“光学及其他”业务收入和毛利率相比2025H1是提速还是持平？4、市场关注CPO/1.6T光引擎封装，请问目前是仅送样认证还是已有小批量订单？苏州CPO/TGV专线Q3是否达产，预计2026年CPO相关收入能否在分部报表中体现独立增量？

回答：您好，公司上半年整体收入相比2025年同期保持平稳弱增长，利润下降主要受到汇兑损失和分拆子公司上市中介费用影响，其中汇兑损失主要受美元与人民币汇率波动影响，公司已通过美元掉期产品来有效降低相关影响，但也需要关注的是汇率对冲措施都有双向影响，最终影响具体还是要看汇率的实际走势。

分拆子公司上市中介费用属于一次性的影响，目前荷兰子公司分拆上市工作正在有序推进，希望通过积极努力，争取能在2026年内完成相关工作。

公司目前生产经营保持正常，随着上半年行业库存消化，下半年市场需求开始恢复增长态势，公司产线稼动率也在稳步提升。

近年来，随着AI智能的快速发展，驱动封装技术从“平面互连”到“立体堆叠”的加速发展，对高密度、高集成等微缩先进封装工艺提出越来越多的创新需求。公司专注于晶圆级TSV先进封装技术服务，核心工艺涵盖BONDING LAST、TSV LAST、STACK LAST，相关技术工艺在堆叠、共封等产业发展趋势中有应用前景，公司正密切关注相关产业动态与市场需求，积极加强技术储备、推进技术创新、市场应用与客户需求拓展，感谢您的关注。

问题二：1、关于CPO、NPO封装。近期英伟达等大厂均表态加速推进CPO、NPO封装特别是光电共封装，A股亦有多家封测公司披露了自身优势及送样验证情况，导致大家更为关心关注公司推进这项工作的进度，由于以前公司一直用很模糊且模式化的语言回答这个问题，使投资者疑问越来越多，甚至失去耐心和信

心。包括资本也在用脚投票。请公司在适度范围内尽可能详尽回答这项工作进度。

2、关于荷兰子公司分拆上市情况。请明确告知目前推进到哪一步，有哪些新进展，包括Anteryon微透镜送样、验证以及与天孚通信合作情况等。

3、关于上半年业绩下降问题。公司上半年利润仅1.33亿，只完成全年一致预期25%左右，而同期长电、通富等同业均大幅增长。现在公司仅轻描淡写的用汇兑损失和子公司分拆上市费用增加来解释原因是说不通的。也让人难以理解和接受。现在关键是下半年怎么办，请问公司将采取哪些得力措施确保完成预期目标，包括扩大营收和规模的措施。

4、关于股权激励事项。如果公司把激励重点放在光学器件业务骨干上，举双手赞成，甚至拿出70多万股都少，可以加大激励人数和权重。但是给董事长赞成，董事长付出很多应该给，但给董秘和财务总监不赞成。

回答：您好，您提到的CPO、NPO市场信息诸多，产业节奏众说纷纭。对于公司而言，认为该技术是在前述问题中所交流的“AI智能的快速发展，驱动封装技术从“平面互连”到立体堆叠的加速发展，对高密度、高集成等微缩先进封装工艺提出越来越多的创新需求”这一产业发展趋势的一个应用场景，建议可以更多关注技术发展背后的产业趋势逻辑。公司成立以来一直专注于晶圆级TSV先进封装技术服务，在BONDING LAST、TSV LAST、STACK LAST等技术工艺具备显著领先优势，相关技术工艺在堆叠、共封等产业发展趋势中有应用前景，公司正在密切关注相关产业动态与市场需求，积极加强技术储备、推进技术能力创新、市场应用与客户需求拓展。

荷兰子公司分拆上市进度详见前述回复，公司与客户的合作情况属于商业信息，请见谅不便于交流。

关于公司业绩情况，从收入端来看，公司上半年收入规模整体平稳弱增长，一方面是消费类电子市场需求疲软，根据IDC数据，2026年上半年全球智能手机出货量同比下降4.8%。另一方面，虽然汽车智能化趋势持续发展，但受到2025年行业激进备货带来的库存影响，2026年上半年车规CIS市场处于去库存态势，影响了整体出货需求。季度上2026年二季度环比2026年一季度，营收规模开始呈现恢复增长态势，与行业库存逐步消化有正向关系，该趋势有望在下半年延续，使得市场需求与出货水平呈现恢复增长态势。从利润端来看，公司上半年利润下降，与收入趋势不一致，主要原因是您所提到的汇兑损失和分拆子公司上市费用所导

致。相关费用的影响请见前述问题回复。感谢您的关注。

本次股权激励股份来源于2024年公司响应“提质增效重回报”从市场上回购的股份，回购股份的用途为股权激励或员工持股计划，当时回购股份数量为74.77万股，这是本次股权激励股份总数确定背景。近年来随着 AI 智能的快速发展，光学器件作为核心感知与传输部件，在半导体设备、工业自动化、光互连、智能应用等领域应用深度持续拓展，下游需求旺盛，行业整体进入战略发展机遇期。公司于 2019 年通过收购荷兰子公司Anteryon，正式切入微型光学器件领域，业务涵盖精密光学设计、晶圆级光学制造、精密玻璃加工、光学系统模块集成等技术与产品。基于公司在光学领域领先的技术能力、核心客户群体、市场发展与行业需求趋势，光学板块业务有望成为公司未来发展新增长点。为有效推动公司光学器件业务的发展，公司计划以本次股权激励计划为抓手，加大对光学业务板块的资源投入与考核激励力度，打造公司业务发展新曲线。本次股权激励对象为光学业务板块的核心管理、技术与业务人员，公司光学业务板块主要由子公司荷兰Anteryon、Anteryon苏州两家公司运营，公司董秘兼财务总监为荷兰Anteryon、Anteryon苏州两家子公司的董事，参与公司光学业务板块的管理与业务发展支持，其作为激励对象符合相关法律法规及公司经营发展实际。感谢您的关注！

问题三：1、根据公司25年经营情况，券商一致预期今年每股收益0.8元，但上半年仅完成每股0.2元。经电话问询，公司证券事务代表答复，公司经营正常，下半年情况会明显好转，营收和利润会大幅增加。请问下半年利润增长点主要体现在哪几个点上，光学器件收入占比会大幅增加吗，经过努力还能完成甚至超额完成全年5.2--5.4亿的预期目标任务吗？2、据公司介绍，在CPO、NPO光电共封装堆叠上，公司占有明显优势，特别是在TSV封装+WLO协同上，公司具有最大的差异化优势。但近期从长电、通富等多家封测公司了解到，这些公司均在CPO、NPO封装上加大产投研布局，有的已在国内外大厂通过送样和验证，成效明显。请问公司在推进这项工作上已经进行到哪一步，是否一直保持领先优势，何时能将领先优势转化为在手订单？3、公司上半年净利润下降两成，其中汇兑损失较大。请问为什么不用远期结汇对冲减少损失哪，还是公司有其他更好更重要的考虑？对汇兑损失，公司财务总监是否应该承担责任？4、近几年公司营收和规模

有一定增长，但相比同业发展速度明显迟缓，请问公司有什么具体改进措施吗？特别是在推进光学器件和AI算力封测上有哪些具体有力的举措？

回答：您好，关于公司上半年业绩分析、下半年展望、CPO、NPO 等技术布局情况，前述问题已有回复，请您详见前述问题回复，感谢您的关注！

问题四：1、从公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）看，旨在加大对光学业务板块的资源投入与考核激励力度，打造公司业务发展新曲线。但据了解，荷兰子公司 Anteryon 分拆上市后，其经营管理人员和业务人员主要或全部从当地招录，那这个考核是否主要应该对荷兰子公司 Anteryon 相关人员进行考核，如果只对国内人员考试还有实际意义吗？还有，从考核指标设定上看，确实明显偏低，这也是一些券商投研人员和投资者认为这是公司在搞自我奖励的原因。2、从另一个角度看，考核指标设定这么低，也容易让市场降低对荷兰 Anteryon 子公司分拆上市后业务发展的信心，与公司大力推进 NPO、CPO 封装的发展定位和实际情况也不相符。建议公司对考核指标进行适当修改，可以增加考核上限，甚至可以设定今年至少比 2025 年增加 30%以上，2027 年比今年增加 50%以上，同时对相关人员进行重奖。

回答：您好，本次股权激励对象为光学业务板块的核心管理、技术与业务人员，其中包括Anteryon主要董事会成员，相关成员同时也是Anteryon业务战略发展、分拆上市等工作的主要负责与推进者。您提到的荷兰Anteryon本土员工激励，子公司自身建立了有效的激励计划与考核机制，以期协同所有员工共同努力、推进业务的持续发展。从激励指标上来看，相关指标涵盖了光学业务及公司整体收入目标，指标即综合了激励性，也考虑了不确定性，具有充分性和合理性。

您提到的NPO、CPO前面已有回复，目前关于这些技术走势的市场信息很多，产业节奏众说纷纭、商业化节点更是难以猜测，建议投资者可以更多关注技术发展背后的产业逻辑，感谢您的关注！

问题五：公司苏州12英寸车规TSV产线此前已公告量产，请问目前该产线的产能利用率达到多少？月出货量是什么水平？2026年上半年车规CIS封装收入占比大概是多少？相比2025年是否有提升？

回答：您好，公司12英寸晶圆级TSV生产线处于量产状态，目前处于满产运营状态，得益于汽车智能化的快速发展，车规CIS市场需求正迎来良好发展机会，公司作为全球为车规CIS产品提供晶圆级TSV封装技术服务的领先企业，将持续聚焦该市场机会，推进业务的持续发展。

问题六：马来西亚基地预计年底打样试生产，请问该基地的目标客户和产品定位是什么？投产后主要承接哪类订单，对2027年的营收贡献预期如何？

回答：马来西亚项目正处设备安装、调试与产线验证阶段，预计年底进入打样试生产阶段，聚焦海外汽车等智能应用终端领域进行市场与客户拓展，感谢您的关注！

问题七：我们注意到，2026年上半年车规CIS行业处于去库存态势，公司营收也仅增长1.39%，但公司存货从2025年末的1.13亿元逆势增加到2026年6月末的1.33亿元，增长18.1%，其中原材料和在产品占比超过80%。请问管理层：这部分增加的库存，是基于已有的明确订单进行的主动备货，还是对下半年行业需求回暖的预判性备货？对应的主要是哪些产品线和客户？

回答：您好，您提到的库存增长是生产备货所需的缘故，以支持CIS等产品的生产需求，感谢您的关注！

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体内容，详见价值在线路演中心（网址：<https://www.ir-online.cn/>）。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2026年9月8日